



2026 年 9 月 2 日～4 日に開催されます「SEMICON Taiwan 2026」に出展いたします
皆様のご来場お待ちしております。

出 展 内 容

【 新機種 パネルレベルパッケージ対応 PLP-700 】

サイズが最大 700 mm×700 mmに対応するパネルレベルパッケージ用の最新設備(PLP-700)のパネル
展示を中心に、半導体設備のご提案を致します。

* PLP-700 詳細情報は SEMICON Taiwan 2026 会場にて

<会場>

・ TOYO ADOTEC ブース Hall 2, 1F, Booth No. Q5946

【 新機種 12 インチ用マルチワイヤーソー MWS-SiC12F 】

大口径インゴット (Φ 1 2 インチ対応※最大 1 4 インチまで) 切断用の最新型マルチワイヤーソー
MWS-SiC12F を中心に、切断加工機のご提案を致します。

* MWS-SiC12F 詳細情報は SEMICON Taiwan 2026 会場にて

<会場>

・ 東栄電子有限公司ブース Hall 2, 4F, Booth No. R7121